

国产存储双雄正式迈入明牌扩张阶段，其中长江存储启动 IPO 辅导工作，2026 年一季度营收突破 200 亿元，同比大增 100%，长鑫科技同期营收高达 508 亿元，同比涨幅 719.13%，归母净利润 247.62 亿元，亮眼业绩充分印证行业整体高景气度；存储行业大规模扩产浪潮下，扩产资本开支中约八成资金流向设备采购，叠加半导体设备国产化率正从 20%-30%稳步向 50%-60%迈进，设备产业链顺势迎来量价齐升的发展黄金周期；与此同时，国家层面持续强调科技自立自强与产业链自主可控，叠加存储龙头 IPO 提速有效提振市场做多情绪，AI 半导体优质科技资产持续受到主流资金追捧，整体政策与市场形成强势共振；在此背景下行业投资主线已然清晰，建议紧抓存储扩产与国产替代两大核心方向，优先布局深度切入半导体龙头供应链、拥有深厚技术壁垒的优质半导体设备企业。

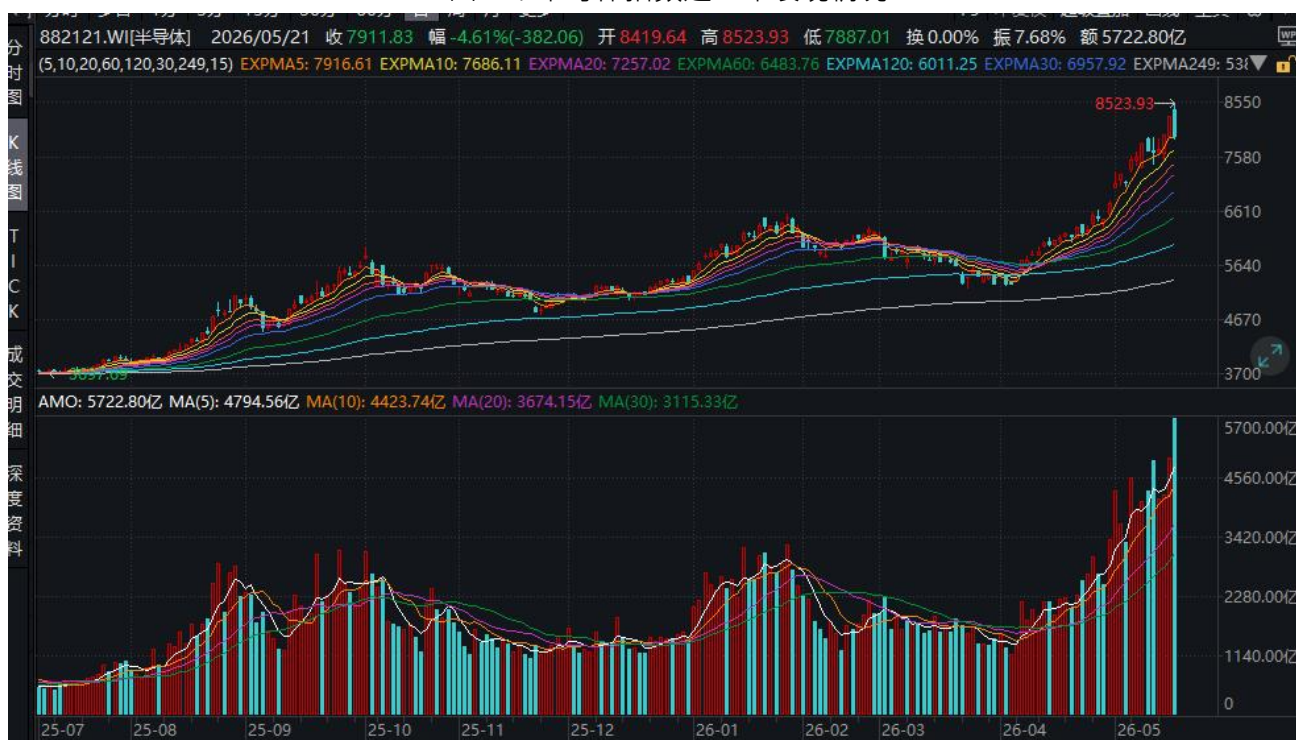
国产存储双雄引领扩产浪潮，半导体设备产业链迎来黄金发展期

据媒体消息，长江存储已启动 IPO 辅导工作，2026 年一季度营收突破 200 亿元，同比实现翻倍增长，全球市场份额稳步攀升至行业第三位。长鑫科技业绩表现更为亮眼，今年一季度营收达 508 亿元，同比大涨 719%，归母净利润接近 248 亿元，根据上交所安排，公司将于 5 月 27 日迎来首发上市审议，同时企业预判 2026 年上半年营收与净利润均将迎来数倍暴涨，此次 IPO 拟募资 295 亿元，全部用于产线升级、存储技术优化及前沿技术研发，两大国产存储龙头正式迈入规模化扩张新阶段。

存储产业持续加码扩产，行业资本开支中约八成资金用于设备采购，叠加半导体设备国产化率从 20%-30%加速提升至 50%-60%，直接推动设备产业链景气度持续上行。在国家大力推进科技自立自强、保障产业链自主可控的政策导向下，存储企业上市提速进一步点燃市场投资情绪，AI 半导体赛道备受资金青睐，带动沪深及港股芯片标的走强，兆易创新 (3986.HK) 屡创历史新高，中芯国际 (0981.HK)、华虹半导体 (1347.HK) 走势强劲。政策与市场形成强劲共振，当前行业投资方向十分明确，建议紧盯存储扩产与国产替代两大主线，重点布局深度绑定芯片龙头供应链、具备高技术壁垒的优质半导体芯片及设备企业。



图一：半导体指数近一年表现情况



资料来源：Wind

► 核心驱动逻辑：政策+周期+AI 三重共振，支撑中长期产业持续高景气

*政策强支撑：锚定科技自立自强，国产替代战略地位持续拔高

2026 年《政府工作报告》将集成电路与人工智能确立为新质生产力核心支撑，正式形成“芯为底座、智为引擎”的双轮驱动格局。其中，集成电路位列新兴支柱产业首位，依托全链条技术攻关与资金政策双重保障，夯实产业硬件根基；人工智能作为智能经济核心引擎，持续拓展全域应用、升级算力基建、完善行业治理。两大产业双向赋能、循环共生，加速半导体国产替代与产业生态完善，推动行业规模与质量同步提升，助力国家科技自立自强与经济高质量发展。同时，差异化政策导向将加剧行业信用分化：深耕核心赛道、技术壁垒高、契合战略方向的头部企业将持续获得资源倾斜、信用优势凸显；而无核心技术、依赖外部供给、陷入同质化内卷的企业，政策支持持续走弱，行业出清有望提速。

其明确两大产业发展方向：一方面实施产业创新工程，培育集成电路、航空航天等新兴支柱产业，鼓励央国企开放应用场景；另一方面推进“人工智能+”行动，推广智能终端与 AI 智能体落地，推动 AI 规模化商业化应用，培育智能经济新业态。政策将集成电路定位为数字经济与高端制造的核心算力底座，将人工智能提升至智能经济核心形态高度，推动两大产业从独立赛道，升级为“硬件底座-智能算法-场景应用”的完整闭环，承担起保障产业链安全、培育经济新动能的双重战略使命。认为以



集成电路与人工智能双轮驱动培育新质生产力，芯片筑牢产业硬件根基，人工智能激活数据要素价值，二者双向赋能、互为支撑，构建产业发展良性循环，既夯实当下支柱产业，又前瞻布局未来新兴赛道，引领产业向高端化、智能化、绿色化转型。而集成电路聚焦全产业链突破，攻坚先进制程、高端芯片、EDA 工具、光刻核心部件等关键技术，加速成熟制程扩产与国产替代；依托政策资金多重扶持加大产业投入，联动各方打通供需渠道，搭建一体化产业集群，稳固产业发展根基，稳步提升核心芯片自给率。人工智能大力推进多领域“AI+”融合应用，孵化各类智能新兴业态；持续完善智算、通信等数字基础设施，夯实全域算力支撑；同步培育开源产业生态，健全行业规范治理，平衡技术创新与风险管控，全方位推动智能产业稳健发展。

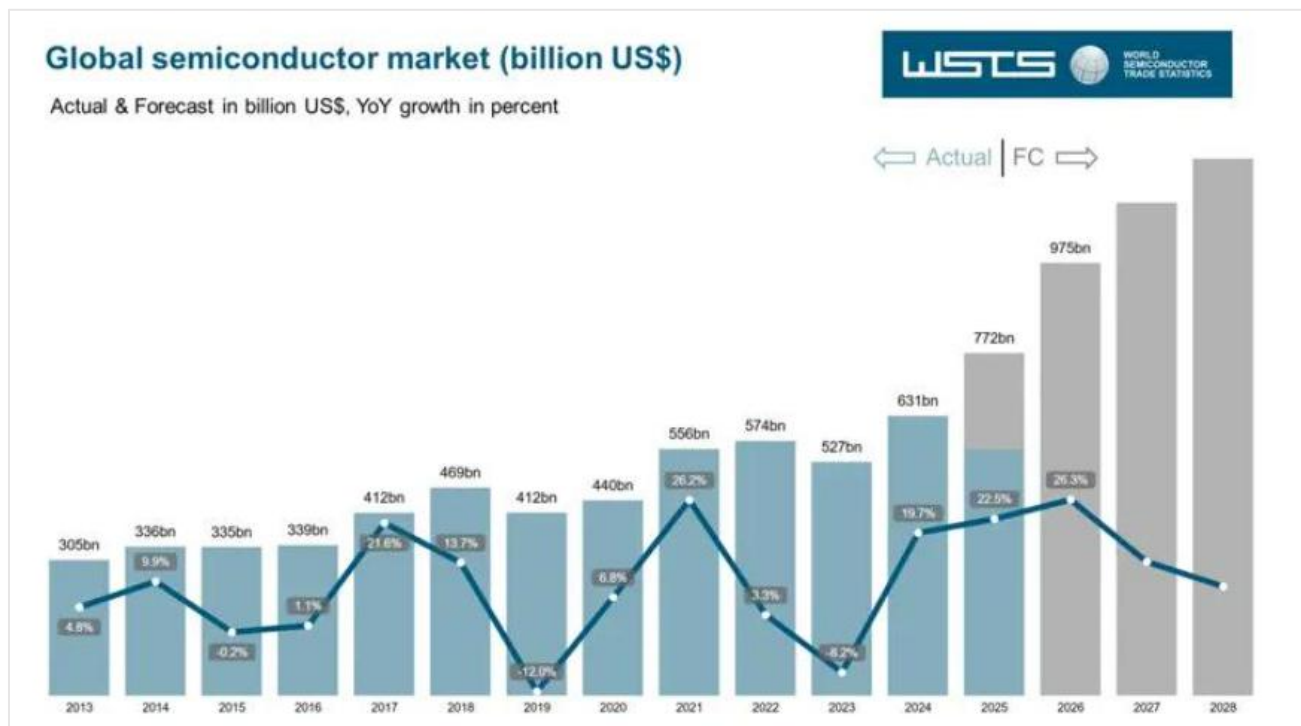
在政策影响上，从产业端来看，集成电路行业全面提速国产替代，成熟制程产能有序放量，先进制程研发攻坚持续加码，产业链设备与材料自主化水平稳步攀升，行业规模不断壮大，有望建成全球第三大芯片产业制造高地。人工智能打破单一应用模式，加速全域行业融合渗透，智能体普及、开源生态完善、算电协同发展成为核心增长动力，依托智能经济新业态，深度打通数字经济与实体经济融合发展路径；企业端而言，集成电路企业迎来资金、应用场景、产业政策全方位扶持，深耕芯片设计、晶圆制造、封装测试及上游设备材料赛道的企业率先享受发展红利。人工智能企业聚焦行业定制化方案、智能终端产品研发与开源生态构建，借助政策扶持拓宽市场渠道，加快前沿技术落地落地，高效实现技术商业化与规模化应用。

*行业周期正式迈入上行通道，供需格局优化叠加存力需求迎来质变

当前全球半导体行业已彻底走出此前长达两年的下行低谷，全面确立强劲的上行复苏周期，数据上看，2026 年全球半导体市场规模预计将突破 9750 亿美元，同比增长超 25%，其中存储与逻辑芯片将成为增长核心引擎。与以往周期不同，本轮复苏并非单纯依赖消费电子周期性回暖，而是由 AI 算力革命驱动的结构性增长，行业景气度正从上游设备材料向下游应用终端逐级传导，形成“上游领涨、中游跟涨、下游回暖”的清晰传导路径，产业链各环节呈现明显分化格局。



圖二：2026 年全球半导体市场规模预计



资料来源：WSTS

当前全球 AI 大模型技术保持高速迭代节奏，模型性能持续优化升级，海内外市场算力布局热潮不减，行业算力军备竞赛愈演愈烈，直接全面拉动高端 GPU、高性能 CPU 等核心算力芯片需求大增，同时带动各类存储产品、先进封装技术以及各层级晶圆代工业务需求集中释放，产业链上下游订单充足、景气度全面抬升。AI 产业高景气行情持续升温发酵，行业应用落地节奏不断加快，算力、存力、晶圆代工三大核心赛道深度绑定，全产业链形成强劲联动共振的上行格局。以英伟达为代表的全球头部科技企业持续搭建完善成熟的算力产业生态，依托自身技术与市场优势，顺势推动 800V 高压直流供电架构、高带宽 HBM 高端存储、碳化硅功率半导体等前沿新兴技术及配套硬件产品加速落地普及，顺利构建起清晰顺畅的产业传导逻辑，打造出算力升级带动存力规模扩容、存力技术革新倒逼晶圆制造工艺持续突破的正向发展循环，产业链协同赋能、联动发展的效应愈发突出。

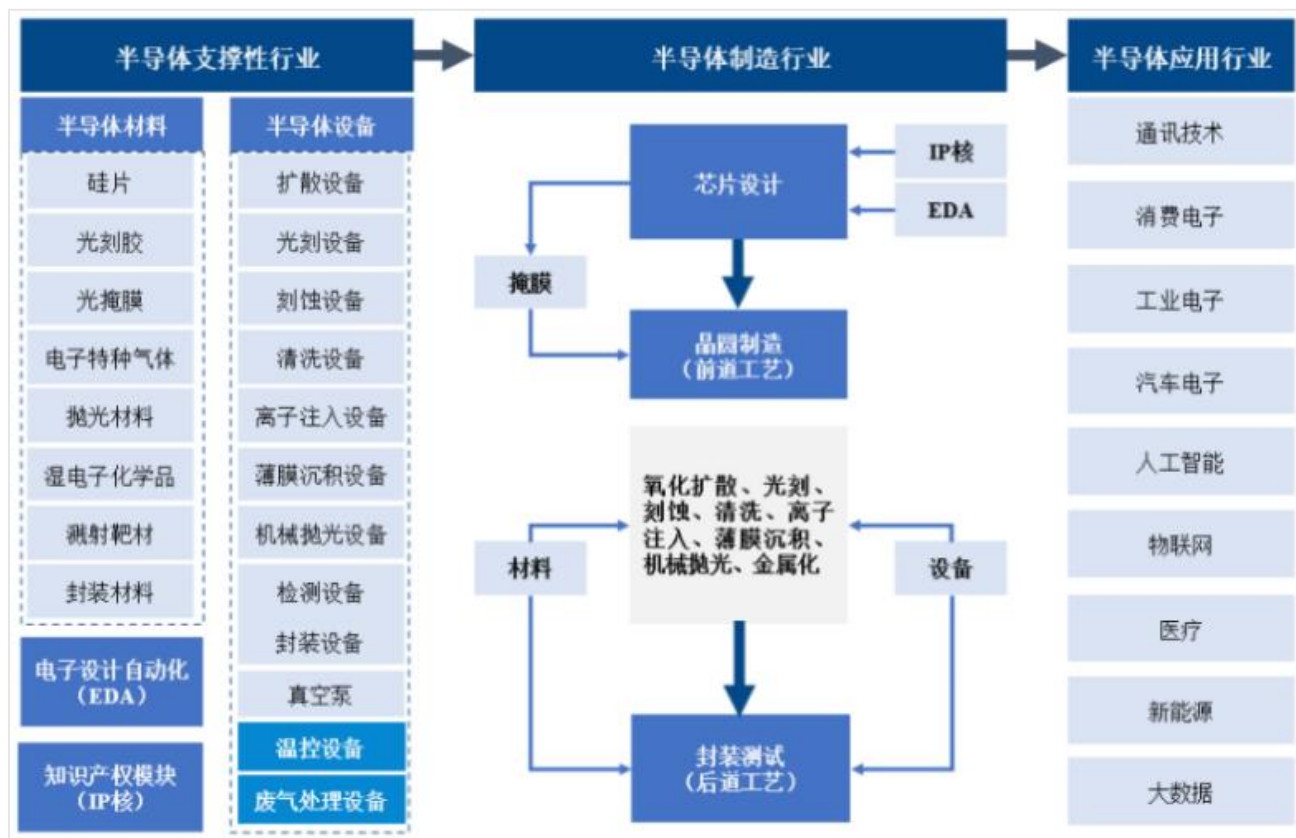
从上游端来看，上游半导体设备、半导体材料率先迎来需求爆发，成为周期复苏的“先行指标”。设备领域中，光刻、刻蚀、薄膜沉积三大核心设备需求最为旺盛，尤其先进制程（7nm 及以下）设备订单排期已延长至 2027 年，国产设备厂商在成熟制程领域的国产化率正快速提升至 30% 以上。材料方面，硅片、光刻胶、电子气体、湿化学品等关键材料需求同步激增，韩国无水氢氟酸商近期开始从中国采购，标志着国产半导体材料在全球供应链中的地位持续提升。

在中游环节，存储芯片与先进封装赛道率先迎来业绩拐点，功率半导体、模拟芯片等细分品类紧随其后。先进封装作为突破摩尔定律的关键技术路径，3D 堆叠、Chiplet 等工艺在 AI 芯片领域的应用推



动相关企业订单量同比增长超 50%；功率半导体受益于新能源汽车与光伏储能需求增长，SiC/GaN 等第三代半导体材料加速渗透；模拟芯片则凭借高壁垒、高毛利特性，成为行业复苏中的“稳定器”。

图三：半导体产业链情况



资料来源：上市公司招股说明书

以存储行业为例，全球存储行业自 2025 年 Q3 完成行业筑底，市场库存经过连续 6 个季度的去化已降至健康水平，DRAM、NAND 闪存产品价格自 2025 年下半年起进入稳步上行通道，其中 DDR5 内存价格累计涨幅超 40%，3D NAND 闪存价格涨幅超 25%。传统消费电子、终端硬件需求稳步回暖，2026 年全球智能手机出货量预计增长 5%，PC 出货量增长 3%，为存储行业提供坚实基本盘支撑。而 AI 产业的飞速发展更是彻底重塑存储行业需求结构，带来“量价齐升”的双重红利。大模型训练与推理落地、大型智算中心规模化扩容，催生高带宽内存 HBM、大容量企业级 SSD 等高端存储产品的刚性需求——AI 服务器的存储配置量为传统服务器的 3-5 倍，单台 AI 服务器 HBM 搭载量可达 128GB-512GB，是普通服务器的 8-32 倍。HBM 作为 AI GPU 的“标配”，全球产能高度集中，SK 海力士、三星等国际巨头订单排期已至 2027 年，国内企业正加速布局 HBM 封装与测试领域。同时，AI 大模型对数据存储的海量需求直接拉动通用 DRAM、消费级 NAND 市场需求持续放量，形成“高端引领、中低端跟进”的全面增长格局。



► 投资策略：结构性机会为主，把握节奏、精选赛道

整体半导体板块以结构性行情为主，投资需精准把握市场节奏、聚焦优质赛道。板块整体具备中长期持续布局价值，但不存在普涨行情，操作上需分层把控：短期 1-3 个月板块由情绪驱动、波动显著放大，需谨慎追高，规避纯情绪炒作的高位标的，耐心等待估值回调消化，同时重点跟踪长鑫科技上会结果、长江存储 IPO 推进进度及月度存储价格核心数据；中期 3-12 个月，AI 算力景气、存储周期复苏、国产产能扩产三重逻辑将持续兑现，成为板块核心支撑；长期来看，国内存储与晶圆制造自主可控进程持续深化，行业全球市场份额有望稳步提升，板块长期配置价值十分突出。

结合行业发展趋势，当前可重点布局三大核心细分赛道。一是存储芯片主线，作为行业核心投资方向，重点关注港股稀缺存储设计标的兆易创新(3986.HK)，以及长鑫存储、长江存储上下游的参股、封测、材料等产业链标的如长电科技(600584.SH)，有研新材(600206.SH)等；二是晶圆代工赛道，聚焦覆盖成熟与先进制程、承接 AI 及存储代工订单的中芯国际(0981.HK)，以及深耕特色工艺、主打功率与 MCU 芯片的华虹半导体(1347.HK)；三是 AI 算力配套赛道，涵盖 HBM、先进封装、半导体设备、EDA 等细分领域，充分受益于行业扩产浪潮与国产替代红利。

但是投资过程中仍需警惕多重潜在风险，规避阶段性回调压力。首先是短期情绪退潮风险，长鑫科技上会、长江存储 IPO 辅导落地属于市场预期兑现节点，叠加板块短期涨幅较大、估值偏高，容易引发资金获利了结，导致板块冲高回落、波动加剧；其次是外部地缘制裁风险，先进制程设备、光刻胶、EDA、高端存储技术等领域受限，可能造成产能扩产、良率提升及 HBM 研发进度不及预期；最后是行业周期与竞争风险，存储价格上行乏力、全球 AI 资本开支放缓、消费电子复苏疲软，将拖累行业整体景气度，同时国内扩产不及预期、良率爬坡缓慢，叠加海外巨头降价竞争，会进一步挤压国内企业盈利空间。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

